

이 보고서는 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

기술분석보고서

 YouTube 요약 영상 보러가기

휘닉스소재(050090)

IT부품

요약
기업현황
재무분석
주요 변동사항 및 전망



작성기관

NICE평가정보(주)

작성자

이혜연 전문연구원

- 본 보고서는 「코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안」의 일환으로 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해, 한국거래소와 한국예탁결제원의 후원을 받아 한국IR협의회가 기술 신용평가기관에 발주하여 작성한 것입니다.
- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미 게재 상태일 수 있습니다.
- 카카오톡에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-2124-6822)으로 연락주시기 바랍니다.

휘닉스소재(050090)

반도체 패키징용 복합소재 전문기업

기업정보(2022/04/11 기준)

대표자	홍석규, 고승범
설립일자	2000년 06월 17일
상장일자	2004년 06월 29일
기업규모	중소기업
업종분류	기타 전자부품 제조업
주요제품	솔더볼, 솔더파우더

시세정보(2022/04/11 기준)

현재가(원)	820
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	649
발행주식수	79,138,942
52주 최고가(원)	1,740
52주 최저가(원)	617
외국인지분율	0.99%
주요주주	(주)한국문화진흥

■ 고부가가치 반도체 소재산업을 선도하는 전문기업

휘닉스소재(이하 동사)는 반도체 패키징용 솔더볼(Solder Ball) 사업을 영위하는 복합소재 전문기업이다. 솔더볼은 반도체 후공정인 패키징 공정에서 활용되는 접합소재이다. 초미세 마이크로 솔더볼, 무연 솔더볼 등 고성능, 고신뢰성 솔더볼을 생산하고 있으며 각종 부품소재의 조성 설계에 대한 원천기술을 확보하고 있다. 주력제품 관련 축적된 기술력과 전문성을 보유하고 있으며 국내외 시장경쟁력 확보를 위해 지속적으로 소재/공정기술 개발에 역량을 집중하고 있다.

■ 전방산업 변동에 민감한 산업

세계 반도체 산업은 호황과 불황이 약 4년 주기로 경기 순환 사이클이 발생하는 특성이 있다. 한국수출입은행 ‘이슈보고서-반도체산업 중장기 전망’에 따르면 반도체 수요처 다변화, 위탁생산 증가 등의 요인으로 인하여 반도체 산업의 경기 순환 주기가 짧아지고 있으며 호황과 불황의 폭이 축소되는 추세로 분석되고 있다. 또한, COVID-19의 영향으로 비대면 전자기기 수요증가, AI, 메타버스 등 신규 산업이 등장함에 따라 반도체 수요가 급격하게 증가하며 반도체 슈퍼사이클을 이끌었다. 한편 동사의 2021년 3분기 누적 매출액은 2020년 동기 대비 감소한 것으로 파악되며 반도체 제조 공정, 반도체 기술이 지속적으로 변화되고 있는 점을 고려하여 향후 사업 및 제품 다각화를 통해 보완이 필요한 것으로 파악된다.

■ 신기술 개발 및 사업 다각화 추진

전 세계적으로 환경 문제의 심각성이 강조되면서 친환경 소재/공정 기술에 대한 수요가 증가하고 있다. 동사는 솔더에 포함된 납성분의 유해성과 환경규제가 발효됨에 따라 주식 기반의 친환경 무연 솔더볼을 주력제품으로 생산하고 있다. 반도체 소재산업이 일본 기업의 과점구도, 대기업들의 사업 참여로 과열된 경쟁 양상을 보이고 있으나 동사는 신소재 개발을 지속하고 있으며 선제적 기술 확보를 위해 노력하고 있다.

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

구분 년	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2019	94	(14.1)	2	1.8	(20)	(21.0)	(7.1)	(5.0)	62.2	-28	397	N/A	1.64
2020	101	7.9	(14)	(13.6)	(44)	(43.4)	(15.9)	(9.9)	59.0	-57	356	N/A	3.22
2021 (개별)	94	-	(31)	(32.9)	(30)	(32.3)	-	-	68.2	-38	318	N/A	2.69

기업경쟁력

반도체 부품소재 제조기업

- **반도체 패키징 공정 소재 전문기업**
 - 솔더볼, 솔더파우더 등 소모성부품 제조 및 공급
- **주력사업의 역량 강화**
 - 응용분야에 따라 특화된 제품군 보유
 - 최적화 및 체계화된 생산 프로세스 및 품질관리
 - 미래 시장 예측을 기반으로 기술로드맵 확립

기술 경쟁력

- **원천기술 확보 및 다양한 소재부품 개발/제조**
 - 고성능, 고신뢰성 솔더볼 조성 개발
 - 고용점, 저용점 솔더볼 개발
 - 초미세 마이크로 솔더볼 개발
 - 고온 신뢰성 합금 소재 개발
- **주요 기술 관련 지식재산권 다수 보유**
 - 국내 특허 13건 이상

핵심기술 및 제품

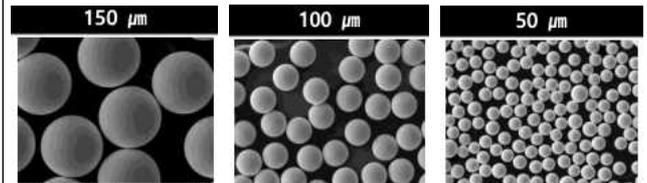
핵심기술

- **솔더볼의 고성능, 고신뢰성, 초미세화**
- **소재기술, 공정기술 기반의 제조역량**
 - 친환경, 고기능성 무연 솔더 소재
 - 저용점 무연 합금 솔더볼
 - 특수 표면처리된 다층 구조의 코어 솔더볼

주력제품

- **솔더볼**
 - 칩과 기판을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 접합소재

솔더볼 이미지



ESG 현황

Environment

항목	현황
환경 정보 공개	■
환경 경영 조직 설치	■
환경 교육 수준	□
환경 성과 평가체계 구축	□
온실가스 배출	□
에너지, 용수 사용	□
신재생 에너지	□

■ : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

Social

항목	현황
인권보호 정책 보유	□
여성/기간제 근로자 근무	■
협력사 지원 프로그램	□
공정거래/반부패 프로그램	□
소비자 안전 관련 인증	□
정보보호 안전 관련 인증	□
사회공헌 프로그램	□

■ : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

Governance

항목	현황
주주의결권 행사 지원제도	■
중장기 배당정책 보유	□
이사회 내 사외이사 보유	■
대표·이사회 독립성	■
감사위원회 운영	■
감사 업무 교육 실시	■
지배구조 정보 공개	■

■ : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

> 환경 정보 공개 및 경영 조직을 별도로 운영하고 있지 않음.
 > 31명의 직원 중 기간제 근로자는 1명(전체 근로자 대비 0.03%)으로 양호한 수준이나, 사회공헌 프로그램 운영 여부, 소비자 및 정보보호 안전 인증 등은 확인되지 않음.
 > 이사회 내 별도 위원회를 구성하고 있지 않으나 사외이사 비중이 25%이며 이사회 운영 규정을 제정하여 준수하고 있음. 또한 전자투표제를 도입 및 활용하고 있는 것으로 파악됨.

* 본 ESG현황은 나이스평가정보㈜가 분석대상 기업으로 입수한 정보를 요약 정리한 것으로, 분석 시점 및 기업의 참여도에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

I. 기업현황

반도체 소재 산업의 선도기업

동사의 주력사업은 고부가가치 소재인 반도체 패키지용 솔더볼 제조로 축적된 기술력과 전문성을 보유하고 있다.

■ 개요 및 사업현황

동사는 반도체 패키지용 솔더볼 제조를 위해 2000년 설립되었으며 2004년 코스닥 시장에 상장되었다. 보광그룹(BGF)에 속해 있었으나 BGF의 독립경영 인정요청에 따라 2020년 기업집단 BGF에서 제외되었다. 본사는 경북 구미시에 위치하고 있으며 2021년 09월 기준 31명의 직원이 근무하고 있다.

본사를 거점으로 해외 및 국내에서 주석(Sn) 및 은(Ag) 원소재 및 비철금속 합금재료를 구매하여 반도체에 활용되는 솔더볼을 생산 및 판매하고 있다. 사업장에는 제품의 생산을 위한 설비와 분석설비를 다양하게 보유하고 있으며 생산성 및 제품 품질을 향상시키기 위한 시스템을 구축하고 있다.

그림 1. 사업장/시설

생산설비			
			
3단 롤밀	소성로	가공기	열처리기
분석설비			
			
ICP	XRF	SEM/EDS	DTA
			
경도계	잔류용력측정기	고온현미경	입도분석기

*출처: 회사소개서(2022), NICE평가정보(주) 재구성

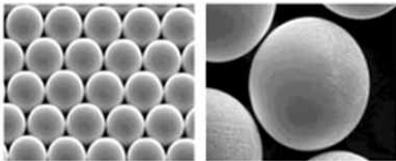
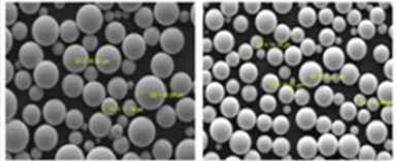
■ 주요제품 및 보유기술

동사는 국내외 반도체 및 패키지 제조기업에 후공정용 소모성 부품인 솔더볼, 솔더파우더 등을 생산하고 있다. 반도체 패키지용 솔더볼은 주석과 납을 주성분으로 하는 합금 물질을 둥글게 뭉쳐 놓은 구 모양의 형태로 반도체 패키지의 하단에 부착하여 PCB(Printed-Circuit Board)에 솔더링하기 위한 용도로 사용하며 칩과 기판을 연결하여 전기적 신호를 전달한다. 동사는 제품경쟁력을 확보하기 위해 고성능, 고신뢰성, 초미세화 등 개발품목을 확대하고 있다.

무연 솔더볼은 고밀도집적회로(Large Scale Integrated Circuit, LSIC)에 주로 사용되고 있으며, 그 외 플립칩 본딩(Flip-Chip Bonding), MCM (Multi-Chip Module), CSP(Chip Scale Package)에도 두루 사용되고 있다. 주력제품으로 SAC 1205(190 μ m), SAC 2505(480 μ m) 등과 100 μ m 이하의 크기를 갖는 마이크로 솔더볼 등을 생산하고 있으며, 30 μ m 이하의 초미세화를 위해 기술개발을 지속하고 있다.

동사의 제품은 표면처리 기술을 통해 고객사 공정에서의 우수한 작업을 수행할 수 있다. 또한 축적된 기술력을 통해 사이즈 공차 및 진구도 관리를 수행하고 있으며 공정 내 온도, 습도 관리와 클린룸 공정 등으로 내산화, 접합력, 젖음성, 고온 신뢰성 등 우수한 특성의 솔더볼을 제조하고 있다. 이처럼 다양한 규격, 균일한 공정조성, 친환경(LEAD-FREE)재질로 높은 품질의 제품을 구현하고 있다.

그림 2. 주요제품

솔더볼		솔더파우더	
<ul style="list-style-type: none"> 칩과 기판을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 접합소재 반도체 패키징 공정의 핵심부품 		<ul style="list-style-type: none"> 솔더페이스트의 주재료 진구도, 입도분포, 산소농도 등 제조 기술력이 필요함. 	
			
구분	크기(μ m)	공차(μ m)	진구도(%)
마이크로 솔더볼	50-99	± 3	≤ 1.5
무연 솔더볼	100-249	± 3	
	250-274	± 4	
	274-299	± 5	
	300-319	± 8	
	320-499	± 10	
	>500	± 15	

*출처: IR자료/홈페이지(2022), NICE평가정보(주) 재구성

■ 매출 현황 및 주요 고객사

반도체 소재(솔더볼) 관련 매출만 고려할 시 2020년 매출액은 10,109백만 원으로 2019년 매출액 9,307백만 원 대비 다소 증가하였다. 한편, 2021년 매출액은 9,421백만 원으로 2020년 대비 감소한 것으로 조사된다. 동사의 고객사는 국내, 중국 등 반도체 및 패키지 제조사들

로 구성되어 있으며 지속적인 거래를 통해 기술력을 인정받고 있어 안정적으로 사업을 영위하고 있다.

그림 3. 주요 고객사



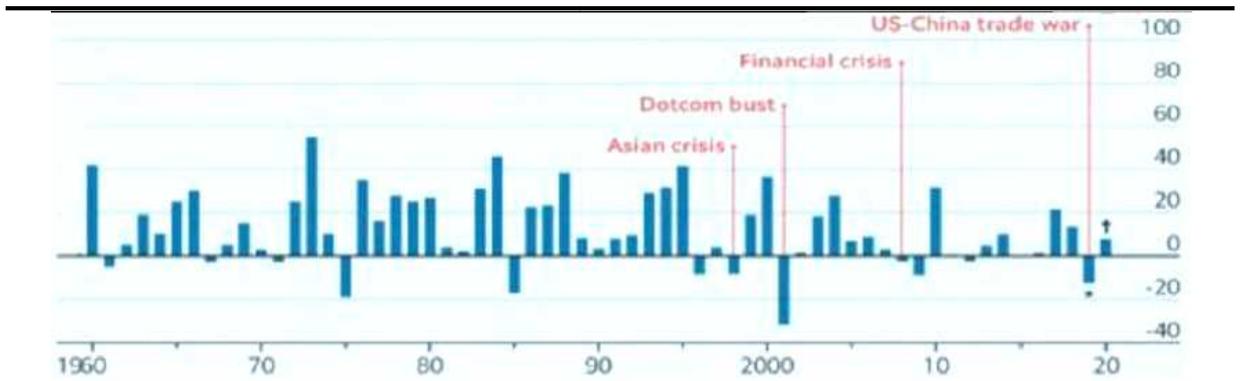
*출처: 동사 홈페이지(2022), NICE평가정보(주) 재구성

■ 시장 현황

세계 반도체 시장의 경우, 1970년 이후 반도체 산업의 호황과 불황이 약 4년 주기로 경기순환 사이클이 발생하는 특성이 있다. 한국수출입은행 ‘이슈보고서-반도체산업 중장기 전망’에 따르면, 2000년대 후반기부터 반도체의 수요처 다변화, 반도체 위탁생산 증가 등의 요인으로 인해 반도체 산업의 경기 순환주기가 짧아지고 있으며, 호황과 불황의 폭이 축소되는 추세로 분석되고 있다. 향후 경기회복, Digital Transformation 가속화에 따른 산업 구조 변화, 수요 다변화 등으로 반도체 수요가 중장기적으로 성장 될 것으로 전망된다.

그림 4. 세계 반도체산업 성장률

(단위: %)



*출처: WSTS, Future Horizons, Economist, 한국수출입은행(2021), NICE평가정보(주) 재구성

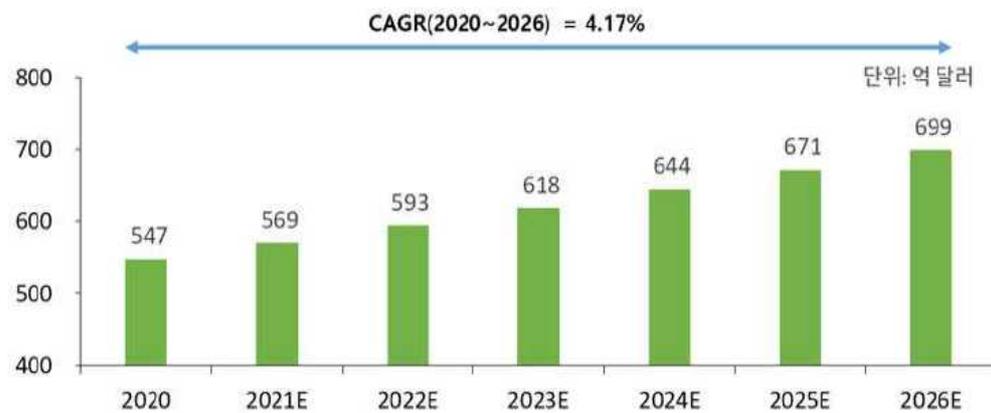
반도체 소재산업은 공정 소재와 부품으로 분류되며 공정소재는 반도체 제조공정에 직접적으로 활용되는 소재로 웨이퍼, 식각액, 가스 등이 포함되고 부품은 반도체 제조 시 간접적으로 소모되는 소재로 주로 장비 소모품으로 구성된다. 동사의 주력제품인 솔더볼은 공정소재 중 후공정 소재에 포함되고 있다. 동 산업은 첨단 기술을 활용하여 재료를 미세 가공하는 고부가가치

산업으로 높은 전기전도도 및 미세 가공을 위한 전기, 화학, 생산 등 다양한 기술력을 필요로 한다. 스마트폰, 노트북 등 전자기기의 소형화 또는 슬림화 추세에 맞춰 꾸준히 수요가 증가하고 있으며 이에 솔더볼의 미세화가 계속되면서 설비에 꾸준히 투자해야하는 장치산업의 특성이 있다.

Mordor Intelligence에서 발간한 시장 보고서인 ‘Semiconductor Materials Market’ (2021)에 따르면, 세계 반도체 소재 시장은 2020년 약 547억 달러에서 연평균 4.17%(CAGR) 성장하여 2026년에는 약 699억 달러의 시장규모를 형성할 것으로 전망된다.

그림 5. 세계 반도체 소재 시장

(단위: 억 달러)



*출처: ‘Semiconductor Materials Market’(2021), Mordor Intelligence, NICE평가정보(주) 재구성

표. 재무 분석

반도체 패키징용 솔더볼 수요 부진으로 매출 감소

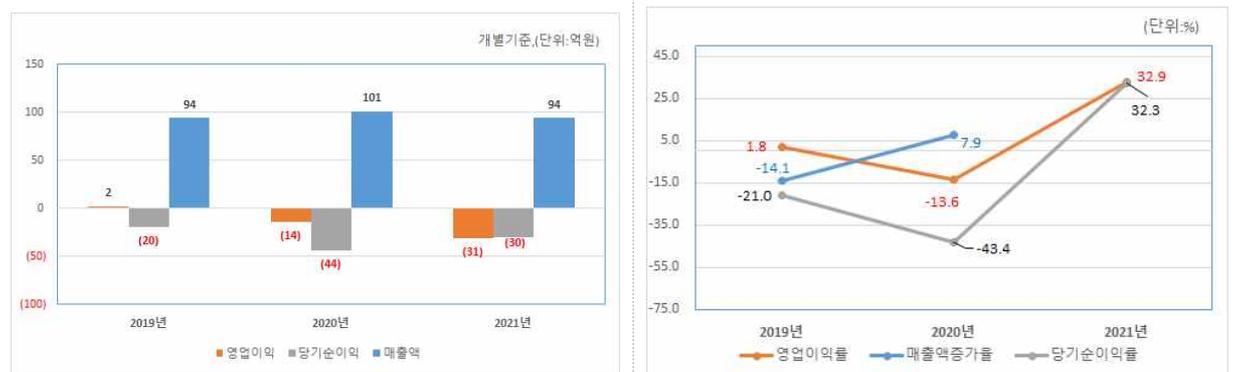
동사는 고부가가치 소재인 반도체 패키징용 솔더볼 제조를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 2021년 결산 기준 국내에서의 솔더볼 수주가 부진하여 전년 대비 6.8% 감소한 94억 원의 매출을 시현하였다.

■ 반도체 패키징용 솔더볼 전문업체

동사는 2000년 6월 설립되어 2004년 6월 코스닥 시장에 상장되었으며, 보광그룹(BGF)에 속해 있었으나 BGF의 독립경영 인정요청에 따라 2020년 기업집단 BGF에서 제외되었고, 2021년 중국 소재 종속기업을 청산하였다.

경상북도 구미시에 위치한 본사를 거점으로 해외 및 국내에서 주석(Sn), 은(Ag) 원소재와 비철금속 합금재료를 구매하여 반도체 패키징용 솔더볼을 생산하고 있다.

그림 6. 동사 연간 요약 포괄손익계산서 분석(21년 개별기준)

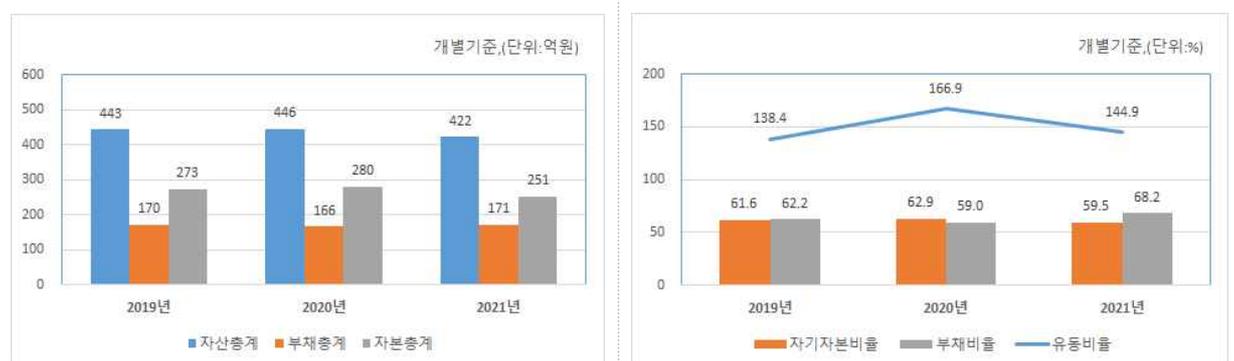


매출액/영업이익/당기순이익 추이

증가율/이익률 추이

*출처: 동사 사업보고서(2021)

그림 7. 동사 연간 요약 재무상태표 분석(21년 개별기준)



부채총계/자본총계/자산총계 추이

유동비율/자기자본비율/부채비율 추이

*출처: 동사 사업보고서(2021)

■ 축적된 기술력을 바탕으로 신제품 개발에 집중

동사의 제품인 솔더볼이란 반도체 후공정 재료로 분류되며, 직접 반도체를 제조하는데 사용되는 재료가 아니라, 반도체 내부의 회로가 외부의 전기적인 신호를 주고받을 수 있도록 연결해주는 패키지(Package)재료이다. 동사는 솔더볼 관련 축적된 기술력과 전문성을 확보하고 있으며 이를 기반으로 각종 전자제품 등의 다양한 분야에 적용 가능한 새로운 제품 개발에 역량을 집중하고 있다.

동사의 매출액은 2019년 94억 원(-17.8% YoY)에서 2020년 101억 원(+7.9% YoY), 2021년 94억 원(-6.8% YoY)을 기록하였다. 2021년 중국향 수출은 전년과 유사한 수준을 유지하였으나 국내에서의 솔더볼 수주가 부진하여 전년 대비 6.8% 감소한 94억 원의 매출을 시현하였다.

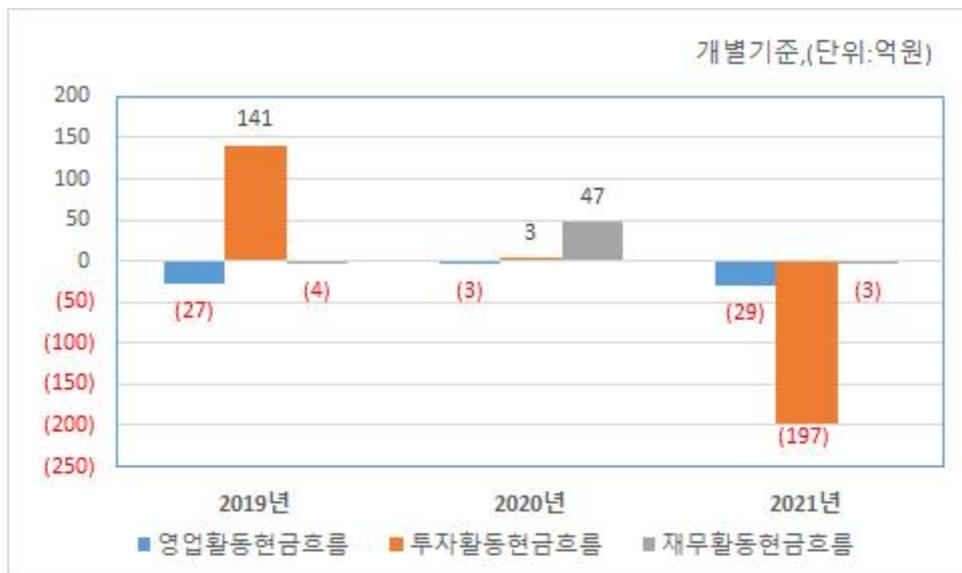
수익성은 매출원가율이 2020년 90.3%에서 2021년 105.6%로 상승하였고, 매출 감소에 따라 판매관리비 부담 또한 확대되면서 매출액영업이익률이 2020년 -13.6%, 2021년 -32.9%를 기록하며 전년 대비 하락하였다. 다만 전년도 일회성비용인 유무형자산손상차손이 제거되면서 매출액순이익률은 2020년 -43.4%, 2021년 -32.3%를 기록하였다.

주요 재무안정성 지표는 부채비율 68.2%, 자기자본비율 59.5%, 유동비율 144.9%를 기록하는 등 전반적으로 양호한 수준을 나타내었다.

■ 보유 현금으로 단기금융상품 취득

2021년 영업활동현금흐름은 당기순손실 시현과 매출채권, 재고자산 증가 등의 영향으로 전년에 이어 부(-)의 상태를 지속하였으며, 부족한 운전자금과 단기금융상품 취득에 필요한 자금은 기보유 현금을 통해 충당하였다.

그림 8. 동사 현금흐름의 변화(21년 개별기준)



*출처: 동사 사업보고서(2021)

Ⅲ. 주요 변동사항 및 전망

반도체 사업 부문 역량 강화 및 친환경 소재/초미세 제품 생산

동사는 반도체 사업 부문 역량 강화에 집중하고 있으며 주력제품인 솔더볼에 대한 매출이 지속적으로 확대될 것으로 전망된다. 한편 차세대 성장동력과 신규 사업의 진출 및 시장 창출에 대한 구체적인 계획을 구상하고 있다.

■ 주요 변동 사항

최근 사업 포트폴리오 다변화, ESG경영 강화 등의 목적으로 상호 변경을 추진하고 있는 기업들이 증가하고 있다. 동사는 2022년 03월 정기주주총회(제22기)를 진행하였고 기업이미지 제고 및 사업다각화를 위해 휘닉스소재(변경전)에서 비케이홀딩스로 상호를 변경하였다. 또한 사업영역 확대 및 신사업 진출을 위한 광고업무 기획 및 대행, 광고물 제작판매 등 7항의 사업목적이 추가되었다.

■ 주요 사업 이슈

비대면 경제산업이 가속화되면서 서버, PC, 노트북 등 IT 디바이스와 5G 등 통신부문 투자가 늘어났으며 COVID-19로 주춤했던 모바일 수요도 하반기 회복세에 접어든 것으로 파악된다. 또한, 2019년 한일무역분쟁, COVID-19 사태에 따른 글로벌 공급망 교란, 2021년 중국발 요소수 공급 문제 등의 이슈가 불거짐에 따라 산업 전반에서 기술자립을 위한 노력이 이행되고 있다. 특히 소재·부품·장비 분야의 국산화율 증대를 위하여 국가 차원의 정책 및 지원제도가 구축됐으며, 2020년 소·부·장 2.0 전략을 발표하여 글로벌시장을 선도하는 소·부·장 강국 도약, 첨단산업 투자유치 및 유턴을 통한 세계적 클러스터화, 범부처, 민관 총력 지원체계 지속 가동을 목표로 다양한 과제를 추진 중이다.

동사는 소재/공정 기술을 기반으로 반도체 패키지의 전기적 특성 향상을 위한 고성능, 고신뢰성 솔더볼을 생산하고 있다. 미래 시장에 대한 예측을 바탕으로 향후 개발이 필요한 기술과 제품의 중장기적 기술로드맵을 확립하여 급변하는 산업에서도 안정적인 제품 구현과 즉각적인 대응이 가능하도록 노력을 기울이고 있다.

그림 9. 2030 소재·부품·장비 산업 목표



*출처: 소재·부품·장비 2.0 전략(2020), NICE평가정보(주) 재구성

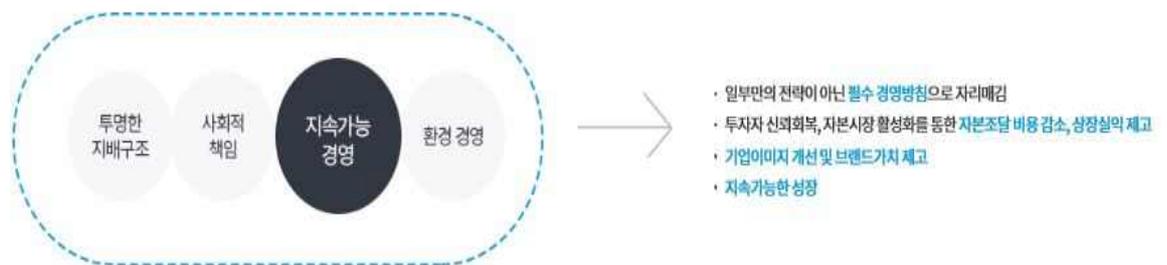
■ 기술에 대한 향후 전망

반도체 패키징 공정 기술은 초소형화 및 시스템화하는 경로를 거치며 점차 발전하고 있다. 여러 칩을 하나로 통합하는 단순한 형태에서 벗어나 기술의 융복합화를 진행하면서 신시장을 창출하고 있다. 동사의 주력제품인 반도체 패키징용 솔더볼은 미세하고 완벽한 구 형태로 균일하게 제조하는 것이 중요하다. 최근에는 용융된 재료를 고속으로 분사하면서 구형으로 굳히는 공정이 적용 중이며 솔더볼이 미세화되면서 크기와 모양을 일정하게 관리하는 기술이 부각될 것으로 예상되고 있다. 또한, 완벽한 구형을 검사하기 위해 다양한 검사 방법이 적용되고 있다. 이처럼 반도체 산업의 발전을 위해 반도체 전 공정 분야와 패키징 분야 그리고 후방산업인 반도체 소재 분야에도 그 중요성을 인식하고 선제적 기술 확보와 노력이 필요한 것으로 분석된다.

■ ESG 활동 현황

ESG는 기업의 비재무적 요소인 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 뜻한다. ESG 평가는 기업엔 지속 가능 경영의 동기를 유발하고 투자자에게는 사회적 책임투자에 대한 접근성을 제고하는 지표로 활용할 수 있다. 국내 ESG 평가를 수행하고 있는 기관은 한국기업지배구조원, 서스틴베스트, QESG, 대신경제연구소, NICE평가정보 등이 있다.

그림 10. ESG



*출처: 한국기업지배구조원 홈페이지

산업통상자원부는 2021년 12월 1일 국내 상황에 적합한 K-ESG 지표를 마련하여 표준화하기 위한 K-ESG 가이드라인을 발표했다. 국내외 주요 13개 평가기관의 3,000여 개 이상의 지표와 측정항목을 분석하여 61개 ESG 이행과 평가의 핵심 공통사항을 마련하고, 관계부처와 각 분야 전문가, 이해관계자의 의견을 반영하여 글로벌 기준에 부합하면서 국내 기업이 활용 가능한 가이드라인을 제시하고 있다.

분야별 진단 항목을 보면 정보공시(P) 분야는 ESG 정보공시 방식, ESG 정보공시 주기, ESG 정보공시 범위 등 5개 문항으로, 환경(E) 분야는 재생 원부자재 비율, 온실가스 배출량, 재생 에너지 사용 비율, 폐기물 재활용 비율, 환경 법규제 위반 등 17개 문항으로 각각 구성됐다. 사회(S) 분야는 정규직 비율, 결사의 자유 보장, 여성 구성원 비율, 산업재해율, 협력사 ESG 지원 등 22개 문항으로, 지배구조(G) 분야는 이사회 내 ESG 안건 상정, 사외이사 비율, 대표이사 이사회 의장 분리, 배당정책 및 이행, 감사기구 전문성 등 17개 문항으로 각각 이뤄졌다.

각 기관마다 차별화된 ESG 평가등급을 공개하고 있으며, 한국기업지배구조원(2022) 및 나이스평가정보(2022)는 S, A+, A, B+, B, C, D 및 ESG1~ESG7 등 7등급 체계로 구성되고, 일부 대기업, 코스닥 상장사의 등급이 제시되어 있다. 당사는 한국기업지배구조원으로부터 ESG 평가 이력을 보유하고 있지 않으나 반도체 소재/부품 산업에 참여하고 있는 일부 상장사의 등급이 제시되어 있다.

표 1. 한국기업지배구조원의 주요 기업 ESG 등급 현황

기업명	기업코드	ESG 등급	환경	사회	지배구조	평가년도
천보	278280	B	D	B	B+	2021
동진세미켐	005290	B+	B+	B+	B	2021
이녹스첨단소재	272290	B	B	D	B+	2021
네패스	033640	C	B	B+	C	2021

*출처: 한국기업지배구조원(2021), NICE평가정보(주) 재구성

서스틴베스트(2022)의 등급은 AA, A, BB, B, C, D, E 7등급으로 제시되고 있으며, 자산 규모별 등급을 구분하고 있다. 2021년 하반기 1,004개의 업체를 평가하였으며 전체 등급은 각 등급별 절대기준을 마련하여 이에 따라 부여된 등급으로 ESG 성과가 우수한 기업을 선별할 수 있다. 규모별 등급은 ESG 평가에서 상대적으로 유리한 여건을 갖춘 대규모 기업들이 높은 점수를 받는 한계를 보완하고 ESG 성과가 우수한 중소기업을 가려내기 위해 도입한 등급체계로 서스틴베스트에서 직전 사업 연도말 자산 총액을 기준으로 평가대상기업들을 2조 원 이상, 5천억 원 이상 2조 원 미만, 5천억 원 미만으로 구분하여 규모별 차등화된 기준에 따라 점수를 산출하여 등급을 부여하였다. 반도체 소재/부품 산업에 참여하고 있는 일부 상장사의 등급이 제시되어 있으나 당사는 평가받은 이력이 없는 것으로 파악된다.

표 2. 서스틴베스트의 주요 기업 ESG 등급 현황

기업명	기업코드	전체 등급	규모별 등급	자산 규모
동진세미켐	005290	B	BB	5천억 이상
네패스	033640	BB	A	5천억 이상
천보	278280	BB	AA	5천억 미만

*출처: 서스틴베스트(2021), NICE평가정보(주) 재구성

한편, 공개 자료를 통해 ESG 항목에 대한 사항을 별도로 확인했으며 당사는 환경정보 공개, 환경 경영 조직 설치, 환경 성과평가체계 구축 등이 파악되지 않았다.

국내 반도체 산업이 글로벌 시장 환경에 맞춰 대응하고 있으나 장기적인 관점에서 새로운 경쟁력 확보가 필요하다는 이야기가 언급되고 있으며 이에 환경경영에 초점을 맞춘 체계적인 지속가능 경영전략이 요구되는 것으로 파악된다. 전력 사용과 온실가스 배출 측면에서 반도체 산업은 환경에 부정적 영향을 준다는 의견이 존재하나 반도체 칩을 탑재한 다양한 전자제품의

전력 소비량을 줄이는 등 전방산업에 대한 친환경 파급효과가 크다. 또한 생산 전, 생산, 사용 단계까지 전반적인 공정에서 환경오염과 자원 사용을 최소화하기 위해 노력하고 있으며 환경 경영을 실천해나가고 있다. 국내외 ESG 평가지표는 다양하나 반도체 산업 특성이 고려된 특화 항목이 반영된 곳으로 소수인 것으로 조사된다. 이에 반도체 산업 특성을 고려한 효율적인 환경경영평가 방안이 수립된다면 국내 반도체 산업에 ESG 환경경영이라는 새로운 경쟁력을 확보할 수 있는 시발점이 될 것이다.

동사는 납 성분의 유해성과 환경오염 유발로 인한 규제가 발효됨에 따라 주석 기반의 무연 솔더볼을 주력제품으로 생산하고 있으며 친환경 소재개발을 지속하고 있다. 경쟁우위를 유지하기 위해 신소재 기반의 기술 고도화를 추진하고 있으며 선제적 기술 확보를 위해 노력하고 있다. 이처럼 ESG 경영은 기업들의 미래 지속가능성을 평가하는 중요한 요소로 선택이 아닌 필수로 자리 잡고 있으며 환경 부문에 있어서 지속적으로 관심과 이슈가 되고 있다. 동사가 안정적으로 발전하기 위해서는 기술 및 경영상의 성장전략을 모색하며 환경규제 강화와 미래 추세에 대응하는 활발한 활동과 다양한 전략이 필요한 것으로 파악된다.

지배구조 부문은 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있으며, 정기주주총회(제22기)를 진행한 이력이 있다. 동사의 이사회는 총 4명으로 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않다. 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있으며 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하는 등의 이사회 운영 규정을 제정하여 준수하고 있다. 또한 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있다. 투표제도의 경우 전자투표제가 도입되어 활용되고 있으며 정기주주총회(제22기)에 실시된 이력이 존재한다.

최근 기업의 사회적 책임에 관한 관심이 제고되고 투자자의 관점에서 투자 적합 기준이 아니라, 모든 구성요소가 인류의 지속가능성을 위해 노력해야 하는 상황에서 그러한 노력의 측정 지표로서 ESG 기준 충족이 필요하다.

■ 증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
<ul style="list-style-type: none"> • 최근 6개월 이내 발간 보고서 없음 			

■ 시장정보(주가 및 거래량)



*출처: Kisvalue(2022.04.)